

「半導体パッケージングの最新動向」

京都実装技術研究会は、昭和62年に発足し、電子機器の生産に深く関わる基盤技術である接合・実装技術を中心に、生産現場の高度化のために必要な課題や各社が抱えている共通の問題をテーマにした活動を行い、参加企業の技術水準向上に努めています。

この度、令和7年度第2回例会を以下のとおり開催します。

◇ 開催日時 令和7年10月17日（金） 13：30～17：00

◇ 開催方式 会場／Web参加 併用（講師は会場でご講演予定です）

◇ 会 場 京都府産業支援センター 5階 研修室
（京都市下京区中堂寺南町134 京都リサーチパーク東地区内）

◇ 内 容
「半導体パッケージングの最新動向」

講師：ヌヴォトンテクノロジージャパン株式会社 技術開発センター
基盤技術開発部 開発推進課／
大阪大学 フレキシブル3D(F3D)実装協働研究所 特任研究員
吉田 浩芳 様

本講演では、半導体産業の最新動向と日本の政策的取組みを概観し、国際標準化活動におけるパッケージング分野の動きを整理する。さらに、材料技術の進展、評価方法や課題を解説するとともに、AI需要拡大に伴うチップレット化と先端実装技術の方向性を展望する。

講演内容：1. 半導体の動向と日本の政策 2. パッケージングの標準化動向
3. パッケージング材料の最新動向 4. AI等のチップレット化

※セミナー後は懇親会も開催します（会費は研究会より補助します）。

◇ 定 員 会場：40名 Web：40名

◇ 参 加 費 会員：無料、非会員：10,000円／社
（研究会入会希望の方は事務局までお問い合わせください。年会費20,000円／社）

◇ 申込締切 令和7年10月15日（水）まで
※懇親会にご参加される場合は10月9日（木）までにお申し込みください。

◇ 申込方法 当センターホームページからお申込みいただけます。
（ <https://www.kptc.jp/kenkyukai/251017jisso/> ）
※E-mail 又は FAX でもお申込みいただけます。

◇ 問合せ先 京都府中小企業技術センター 応用技術課 電気通信係
（京都実装技術研究会事務局）
TEL 075-315-8634 FAX 075-315-9497
E-mail jisso@kptc.jp

令和7年度 京都実装技術研究会 第2回例会 申込書
「半導体パッケージングの最新動向」(10/17)

会社名					
所在地					
連絡担当者	所属・役職				
	氏名				
	E-mail				
	電話番号				
	参加方法	☐ 会場 ☐ Web ☐ 連絡のみ担当（本人は不参加）			
	懇親会	☐ 参加 ☐ 不参加			
参加者	所属・役職	氏名	E-mail ※個別連絡も希望する場合は記入	参加方法	懇親会
				☐ 会場 ☐ Web	☐ 参加 ☐ 不参加
				☐ 会場 ☐ Web	☐ 参加 ☐ 不参加
				☐ 会場 ☐ Web	☐ 参加 ☐ 不参加
				☐ 会場 ☐ Web	☐ 参加 ☐ 不参加
備考					

※懇親会へのご参加を希望される場合は 10/9（木）までにお申込みください。

（期限後にご連絡いただいた場合は、会場手配の都合上、参加をお断りする場合があります）

※申込書に御記入いただいた個人情報は、本研究会受講者名簿として活用させていただきます。

受講に当たっての注意点

- Web参加は、原則1事業所1接続でお願いします。多人数で参加される場合は、プロジェクターやスピーカー等のご準備をお願いします。
- 録画、録音等の配信データの記録、保存は一切禁止です。
- 発熱等の症状がある方は、ご来場をお控えください。